

UV-YAG対応低誘電銅張積層板 『フッ素タイプFUシリーズ』

使用例

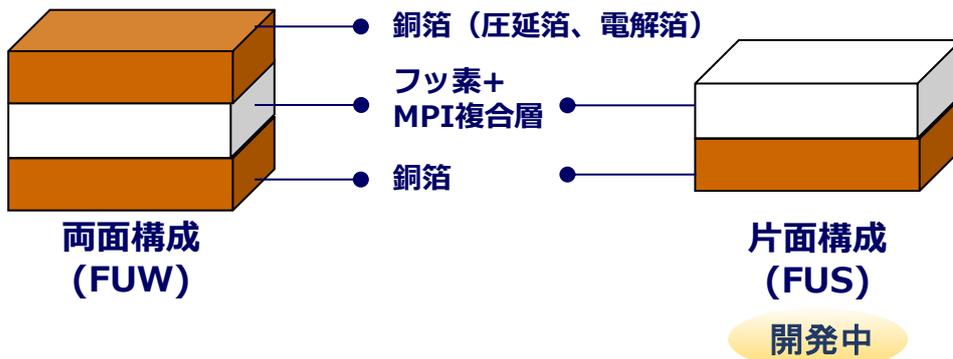
- ・ 車載用アンテナ基板 (LiDAR等)
- ・ 基地局用アンテナ基板
- ・ ミリ波対応フレキシブル高速基板
(アンテナ回路基板)



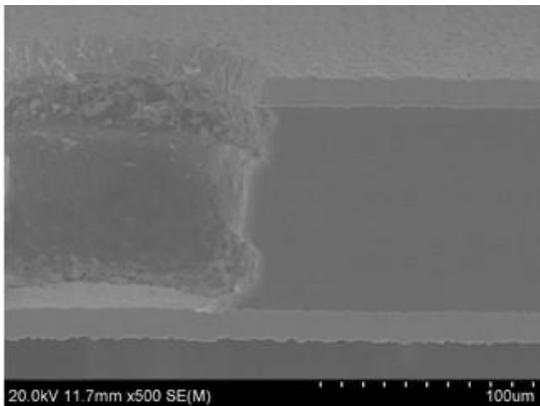
特徴

- ・ 優れた誘電特性(低Dk、低Df)、低吸水性を示す銅張積層板です。
- ・ 一般的なPI系FCCL同様にUV-YAGレーザー加工が可能です。
- ・ 絶縁層厚さは25、50、75、100 μ mを取り揃えています。

構成

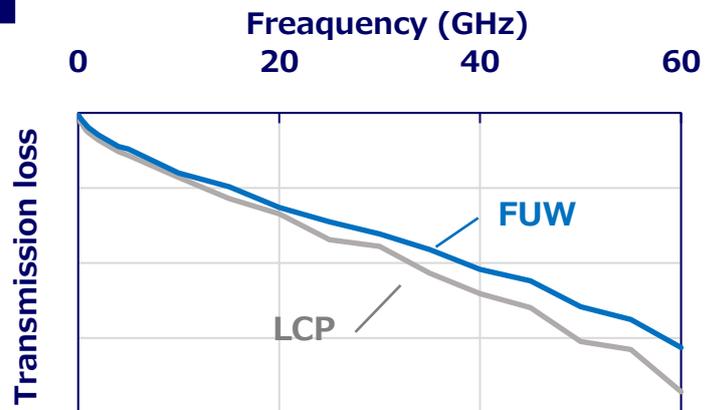


BVH加工後の断面



穴加工 : UV-YAG($\lambda=355$ nm)
絶縁層厚さ : 100 μ m

伝送損失



試料構成 : マイクロストリップ
インピーダンス : 設計値50 \pm 5 Ω
測定環境 : 23 $^{\circ}$ C、50%RH
絶縁層厚さ : FUW, LCP 100 μ m
銅箔厚さ : 12 μ m
回路長 : 100mm